

科技美元下的 AI 浪潮與市場機會

主講人：統一投顧首席經濟學家 呂政道

2026.06.16



AI 與算力



雲端與數據



全球資本流動



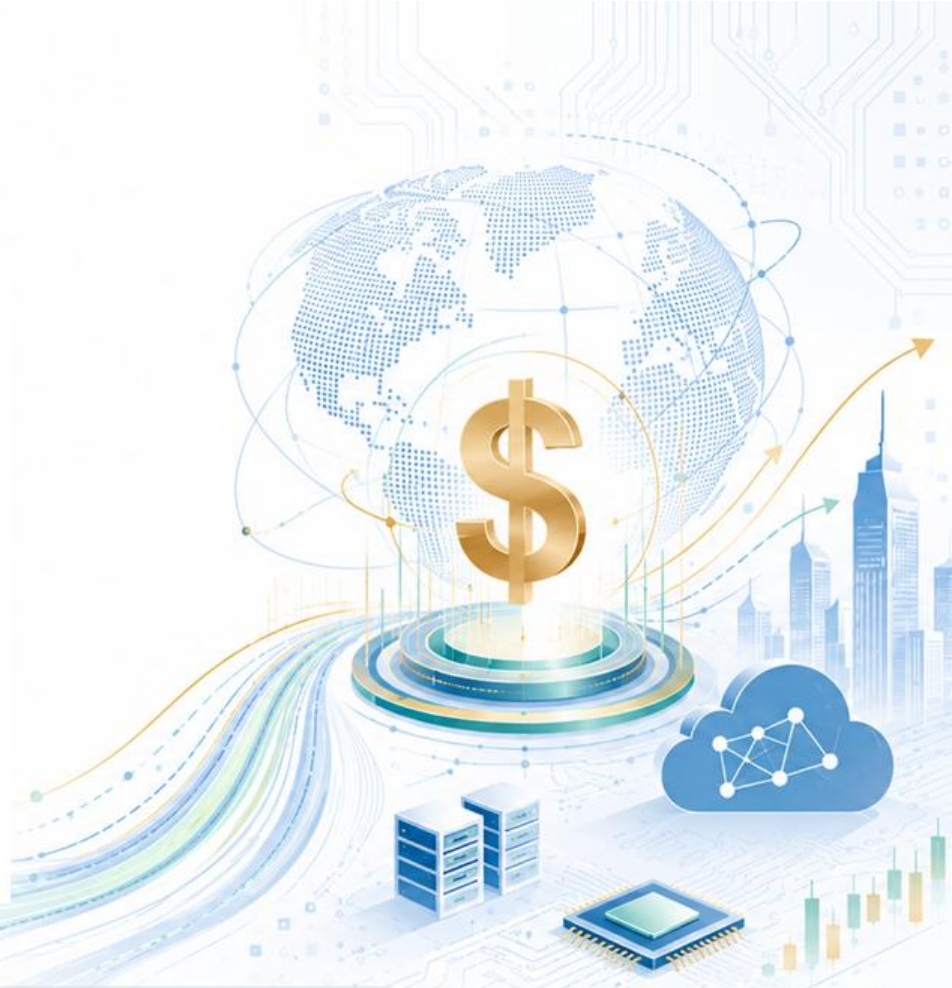
市場機會



目錄

Contents

- 01 科技美元驅動再工業化
- 02 地緣衝突重塑降息路徑
- 03 AI商業變現與市場機會



AI 與算力



雲端與數據



全球資本流動



市場機會

01 科技美元驅動再工業化

科技美元戰略驅動全球工業革命，重塑人類文明史詩級黃金時代

- 透過產能重排、技術定錨、資本回流三部曲，驅動 AI 紅利變現與再工業化，重塑美元霸權。

科技美元閉環



科技美元制度封環三階段

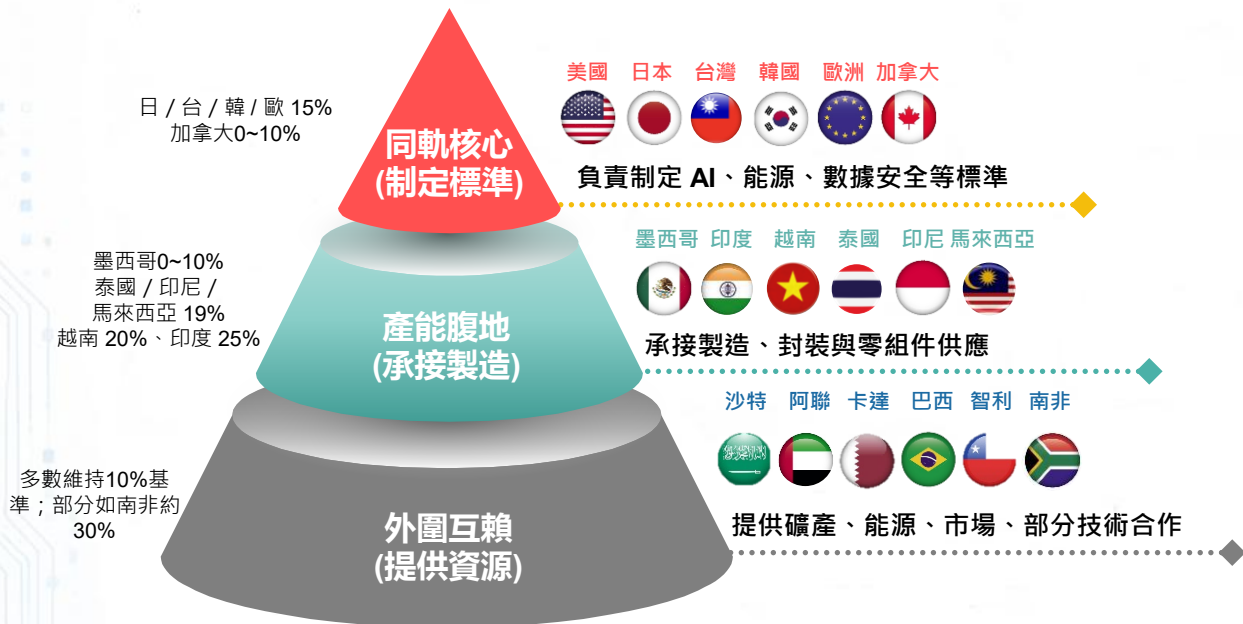
階段	產能重排	技術定錨	資本回流
時間	2017~2025年	2025~2026年	2026年~2028年
戰略目標	生產鏈美元化	技術取代石油	鏈上資本回流
手段	用關稅、補貼、友岸協議重新分配產能與資本流，鎖回美元友善供應鏈	AI / 算力供應鏈讓美元與技術緊密掛鉤，形成科技版「金本位」	穩定幣 x 代幣化美債 x 鏈上結算，使美元能在全球鏈上自由流動，並回流至美債與資本市場
核心機制	關稅、補貼、友案協議	AI、晶片、能源、資料中心、AI永動機	穩定幣、RWA、DeFi
政策工具	IEEPA、232、301、反傾銷、DPA、CHIPS、IRA、基建法案、DFC、大而美法案	Nvidia生態系、AI行動計畫 (America's AI Action Plan) 創世紀任務計畫 (Genesis Mission)	天才法案、清晰法案

AI硬體 軟體應用

AI 革命硬體領跑，台灣穩坐供應鏈核心躍升全球資本匯聚之地

- 台灣憑藉先進封裝與 AI 製造定錨全球核心供應鏈，成為全球資本佈局與技術變現必經之地。

科技美元主導的新貿易體系



國家	關鍵角色
美國	能源、AI、雲端中樞
台灣	先進封裝與AI製造
日本	材料與製程技術
韓國	記憶體與模組整合
歐洲	核能與綠能技術
加拿大	礦產、能源、原物料

名目對等關稅 10%，
但疊加 301 + 芬太尼稅，
有效稅負約 50%

嵌入美元體系平行核心



體系外

制裁與禁運為主，
關稅已非主要工具

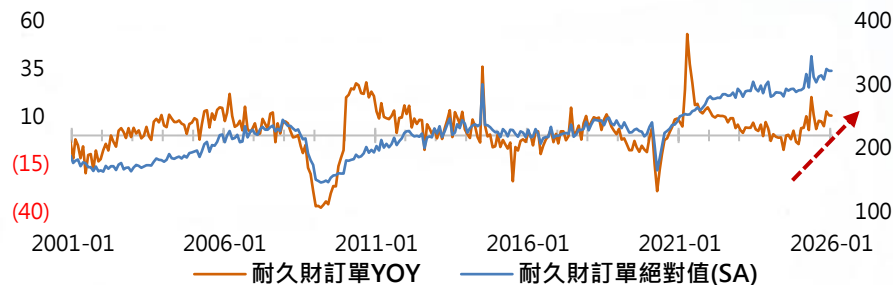
美國經濟展現絕對實力，構築最強增長主旋律

- 美國經濟憑藉強韌的就業市場、AI驅動的生產力提升與內需，展現超越全球的強勁增長。

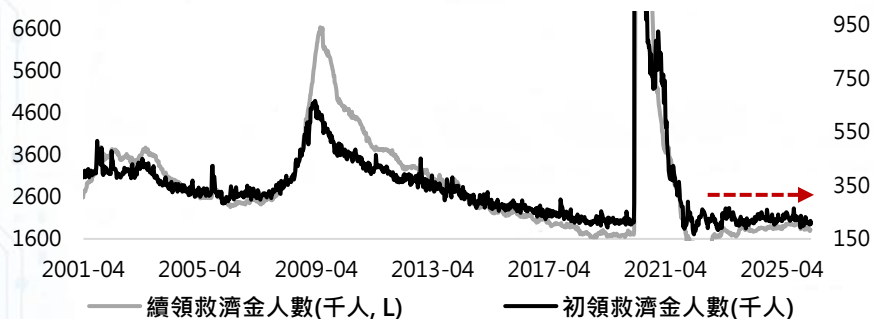
美國-製造業與非製造業PMI



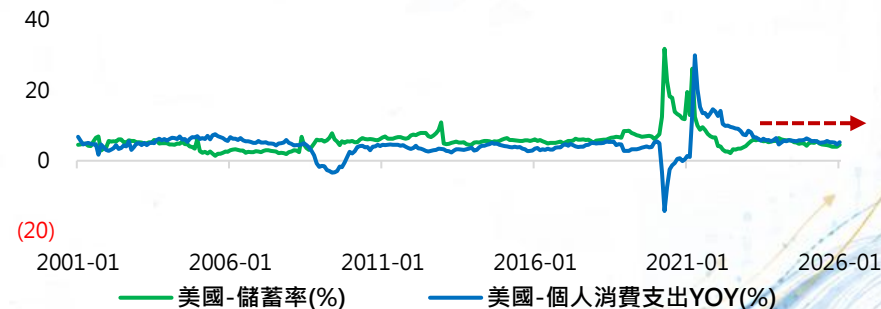
美國-耐久財訂單



美國-初領與續領失業救濟金人數



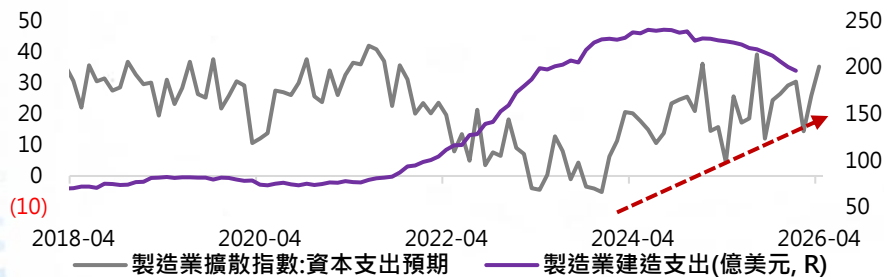
美國-個人消費支出與儲蓄率



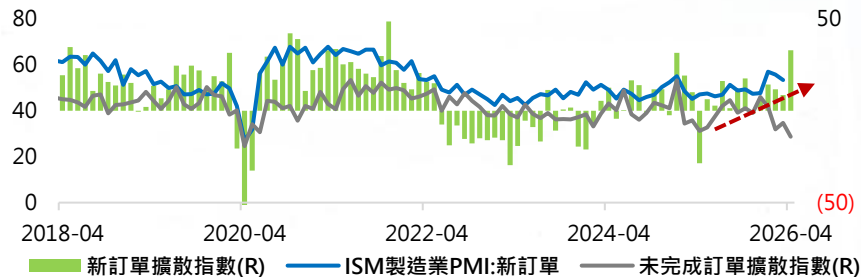
再工業化進程持續推進，重塑全美產業鏈競爭力

- 從建廠投資、訂單到庫存循環好轉，結合PMI重返擴張，證實美再工業化正重塑產業競爭力。

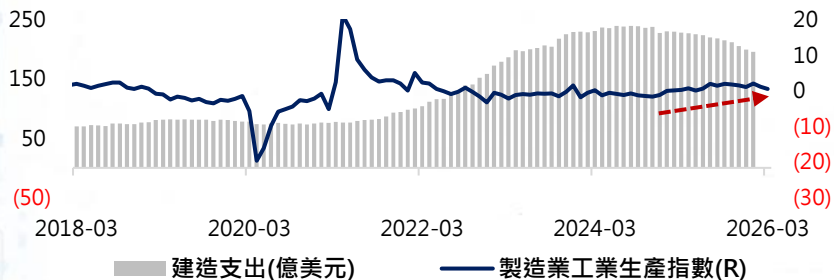
美國-建築業建造支出與製造業資本支出預期



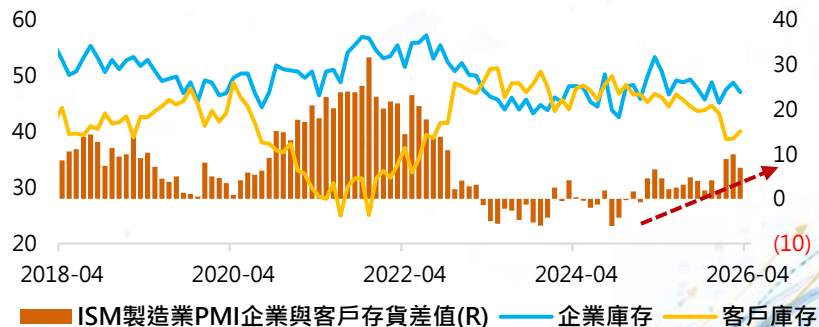
美國-訂單需求與在手訂單



美國-建廠投資與工業生產

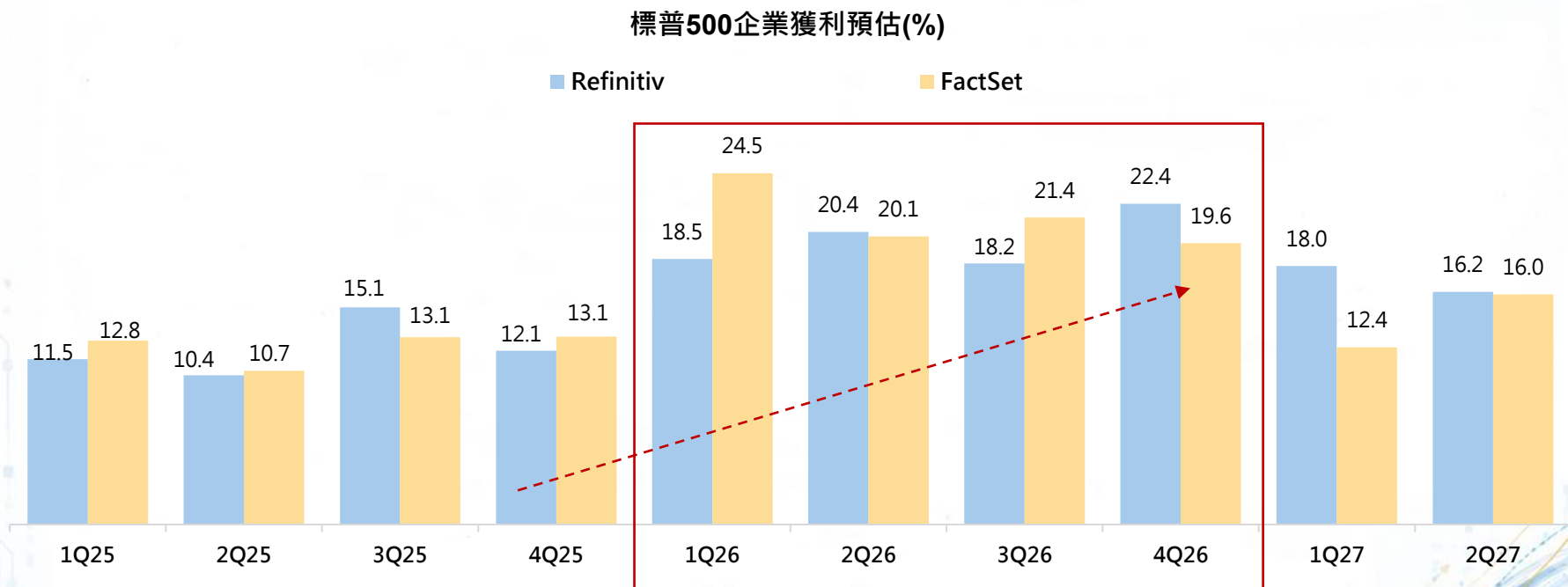


美國-企業庫存與客戶庫存



AI 點石成金，引領美股企業獲利進入暴力上修週期

- 年初以來(至5/1)，Refinitiv大幅調升標普500企業獲利5.3%至20.9%YOY，較25年大增8.3%。



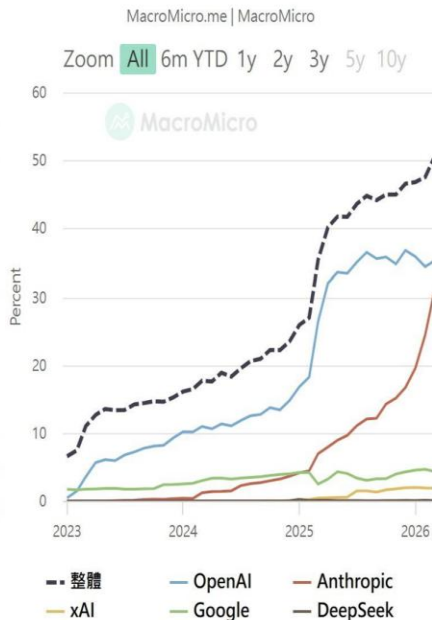
AI 投資不是打水漂，而是正在轉化為實質競爭力與營收

- AI 投資將逐漸由「研發成本」轉化為「成長動能」與「利潤來源」。

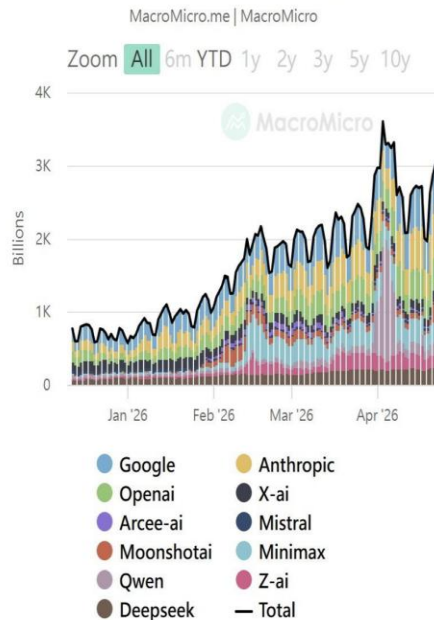
美股1Q26財報季重點公司獲利與展望

公司	預估EPS	實際EPS	法說會與營運重點
Google	\$2.81	\$5.11	● 雲端營收年增63%，提高2026年資本支出
Microsoft	\$4.06	\$4.27	● 雲端增長40%，符合預期但財測未見加速
Meta	\$6.79	\$7.31	● 資本支出上調，市場擔憂AI變現路徑不明
Amazoz	\$1.64	\$2.78	● 加速AI基礎設施，AWS營收增速15季新高
Qualcomm	\$2.56	\$2.65	● 車用營收連兩季突破10億，加速進軍AI市場
Apple	\$1.95	\$2.01	● iPhone需求強勁，AI將整合至所有平台

美國-Ramp AI指數-企業採用AI比率(模型別)



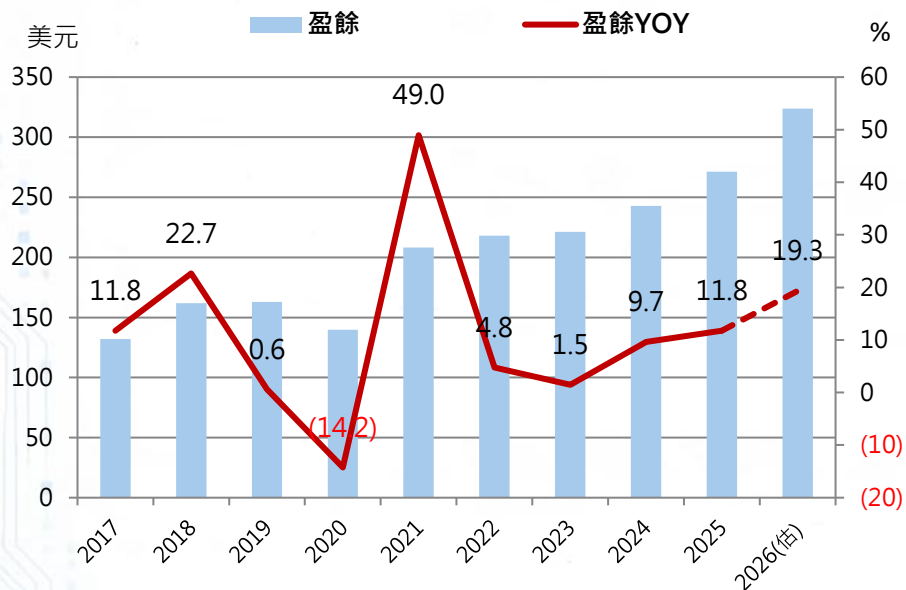
全球-OpenRouter Token 使用量



資本市場結構良好，美股前景光明燦爛

- 若2026年標普500企業獲利成長19%，以評價26x預估高點約落在8,400點。

Factset對標普500 EPS預估



標普500指數敏感度分析

EPS \ PER	17.2 (長期平均)	17.9 (25年最低)	25.6 (25年最高)	26.0 (審慎樂觀)
271.3 (2025年)	4658	4834	6945	7054
298.4 (成長10%)	5124	5318	7640	7759
312.0 (成長15%)	5357	5560	7987	8112
322.8 (成長19%)	5543	5753	8265	8394

02 地緣衝突重塑降息路徑

緊縮的流動性，是唯一可能壓抑AI擴張速度的關鍵因子

- 1H26因美伊衝突推升油價，引發升息預期，引發市場流動性緊縮的疑慮。

AI顛覆軟體業

大摩預警

私募信貸違約率預測

8% 接近疫情時期高點

SaaS商業模式崩壞

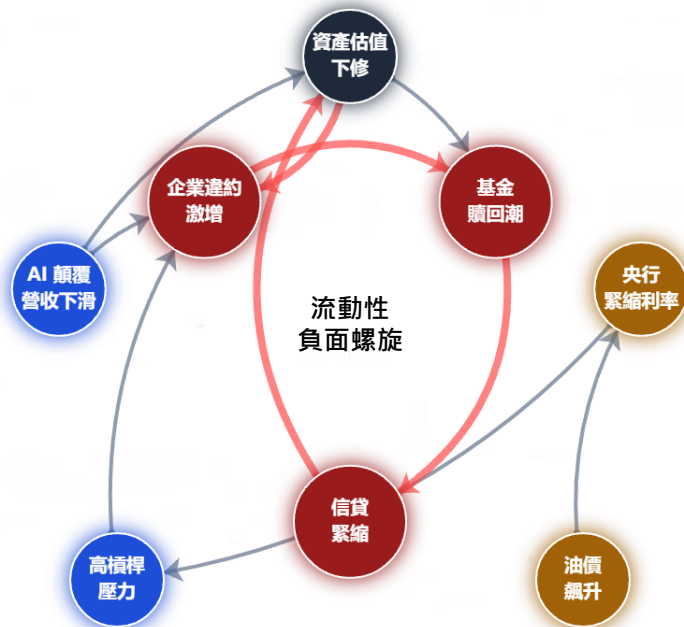
AI自動化取代傳統SaaS訂閱需求
軟體業站私募直接借貸市場~20%
PE支持貸款中軟體業占比高達40%

流動性危機訊號

Blackstone BCRED
淨流出\$1.7B

Blackstone HLEND
贖回達上限

負面回饋迴圈



美伊戰爭與油價

通膨再起

荷姆茲海峽封鎖風險

20% 全球石油供應受阻

央行被迫緊縮

FED(聯準會)
ECB(歐央行)
BOE(英央行)

暫緩降息/考慮升息
市場定價3次升息
60% 機率升息

高利率環境衝擊

資金成本上升直接打擊高槓桿軟體公司，
加劇再融資難度，加速違約發生

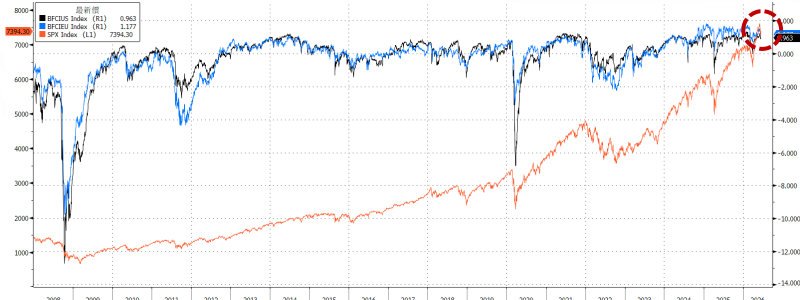
充裕的资金池，证明了流动性断链风险纯属多虑

- 信用利差未失控、金融压力维持低档、资金市场运作顺畅，显示系统性风险受控于安全区间。

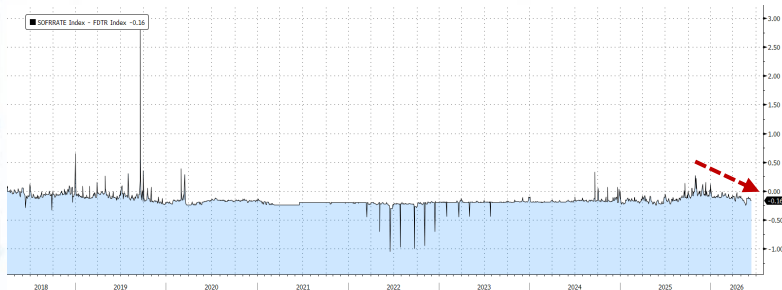
美國-信用風險利差



美國-金融壓力指數



美國-SOFR-EFFR 利差



美國-銀行準備金



荷姆茲海峽通行受阻，對全球經濟影響並沒有想像中那麼大

- 異於俄烏戰爭爆發於疫情後需求巔峰與斷鏈期；本次能源依賴度降低且供應鏈已具調整韌性。

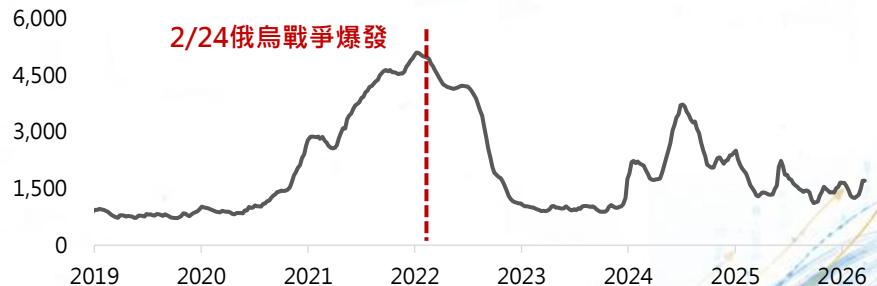
荷姆茲海峽受阻-供應鏈衝擊與流向

類別	品項	全球貿易佔比	主要買家	預估缺口
能源	LNG	20%	日、韓、台、中、歐	85%
	原油	25%	中、印、日、韓、東南亞	50%
燃料	油品(柴/航)	15-20%	歐洲、東南亞、澳、紐	30%
工業	石腦油	16%	中、日、韓、台(裂解廠)	25%
	氬氣	30%	美、中、台、德(半導體廠)	50%
農業	硫磺	45%	摩洛哥、印度、中國、巴西	30%
	尿素(化肥)	34%	巴西、印度、澳洲、東南亞	20%

全球供應鏈壓力指數

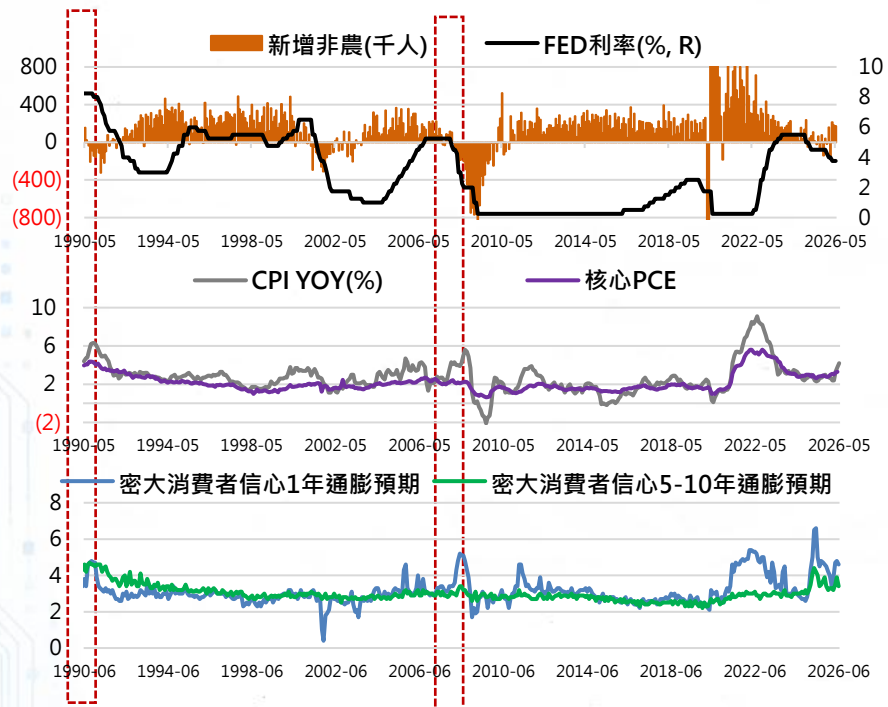


SCFI綜合指數



油價短期脈衝不會引發「二次通膨」，今年仍有望重啟降息

- 由於終端需求偏溫，高油價的「稅收效應」會侵蝕消費、抑制經濟成長，而非推升通膨。



美國-油價、通膨、經濟成長(3月預估)

油價位階 (WTI 26年均價)	綜合CPI (12月 YoY)	核心CPI (12月 YoY)	實質GDP (全年平均)	Fed 政策預估	發生 機率
\$70 - \$85 (基準情境)	2.4%	2.0% - 2.1%	2.5%- 2.8%	全年降 2碼 首降延至Q3	最高
\$90 - \$105 (目前水準)	3.0% - 3.2%	2.3% - 2.4%	2.1%- 2.2%	全年降1碼 首降延至Q4	次高
\$115 - \$125 (持續衝擊)	3.8% - 4.2%	2.7% - 2.9%	1.6%- 1.8%	先暫停降息， 再加速降息	次低
\$140+ (極端斷供)	> 5.5%	> 3.5%	< +1.0%	先暫停降息， 再急速降息	最低

FED新主席華許傾向先降息再縮表，效法「調控大師」葛林斯潘

- 華許主張大幅降息以支持科技轉型。

FED政策框架

階段	AIT/FAIT 時期	現行FIT時期	Warsh新框架 (預期)
時程	2020年8月-2025年8月	2025年8月-2026年	2027年以後
核心制度	平均通膨目標制	靈活通膨目標制	指標導向區間制
通膨目標值	固定 2.0% (允許短期超標補償)	固定 2.0% (不對稱、既往不咎)	1.0% - 3.0% 彈性區間
首選參考指標	核心 PCE(Core PCE)	核心 PCE (Core PCE)	修正平均數 PCE (Trimmed Mean)
對待衝擊態度	容忍通膨以換取就業 (鴿派)	嚴防預期脫鉤，捍衛 2%(鷹派)	看透供給側噪音 (如油價、AI)
溝通策略	前瞻指引 (承諾利率路徑)	數據導向 (Data-dependent)	規則導向 (廢除路徑預告)
資產負債表	量化寬鬆(QE)/緩步縮表	系統性縮表 (QT)	激進縮表至常態化 (MBS 清零)

核心PCE與截尾平均數 PCE(年增率)

2026年/月	Headline PCE	Core PCE	Trimmed Mean PCE
2月	2.8%	3.0%	2.3%
3月	3.5%	3.2%	2.4%
4月	3.8%	3.3%	2.3%
5月 (預測)	4.1%	3.3%	2.8% - 3.0%

#Trimmed Mean PCE (截尾平均數)

$$\text{Trimmed Mean PCE} = \frac{\sum_{i \in \text{remains}} (w_i \times \Delta p_i)}{\sum_{i \in \text{remains}} w_i}$$

其中 w_i 為項目權重， Δp_i 為該項目變動率。

- 定義：將個人消費支出 (PCE) 中的所有細項 (約 177 項)，依據該月價格變動百分比由小到大排列，剔除權重最高與最低的極端值後，計算剩餘項目的加權平均。
- 計算方式 (達拉斯聯準會標準)：
 - 剔除底部：排除漲幅最低 (或跌幅最大) 的 24% 權重項目。
 - 剔除頂部：排除漲幅最高 (最極端) 的 31% 權重項目。
 - 加權平均：對剩餘中間 45% 的項目進行加權計算。

華許師承「德魯肯米勒」，想讓長端利率回歸市場機制

- 金融體系制度改革紅利，才是下半年更值得關注的重點。



FED新主席-Kevin Warsh

類別	核心內容
背景	前FED理事(2006–2011)，歷經 2008 金融危機決策
市場視角	出身華爾街，高度重視流動性與金融穩定
政策風格	務實派，不是教條鷹派
對縮表態度	批評 QE 副作用，但反對在金融條件不穩時急縮表
短期政策判斷	短期不會縮表，利率工具優先
通膨 vs 穩定	認為「政策失誤」比通膨更危險
與川普契合度	成長優先、避免打擊市場，與川普經濟路線高度契合

1981年：創立杜本資本管理
1988年：受邀加入索羅斯基金
擔任量子基金首席經理人
1989-2000年：擔任索羅斯基金執行長
1992年：與索羅斯聯手做空英鎊
2000年：離開索羅斯，回歸杜尚資本
2010年：關閉杜尚資本，轉型為家族辦公室



幕後的影子教父
Stanley Druckenmiller
(杜尚資本前董事長兼總裁)

反對「財政支配」：
聯準會不應是財政部的提款機

1992年聘請貝森特進入索羅斯基金管理公司(共事8年)



財政部長
Scott Bessent
(前索羅斯基金投資長)

透過政策「強迫」
資金進入實體製造，
而非在金融帳戶裡
打轉

1992年德魯肯米勒聘請貝森特進
入索羅斯基金管理公司，共事8年



FED主席
Kevin Warsh
(前杜尚家族辦公室合夥人)

追求「健全貨幣
(Sound Money)」，
恢復市場定價功能

降息 (Rate Cut)

核心目標：減輕負擔、支持實體

- 緩解美國政府龐大的國債利息支出壓力
- 降低企業融資成本，為「再工業化」與「AI科技轉型」提供資金優勢
- 預防高利率對脆弱經濟部門造成硬著陸風險

+

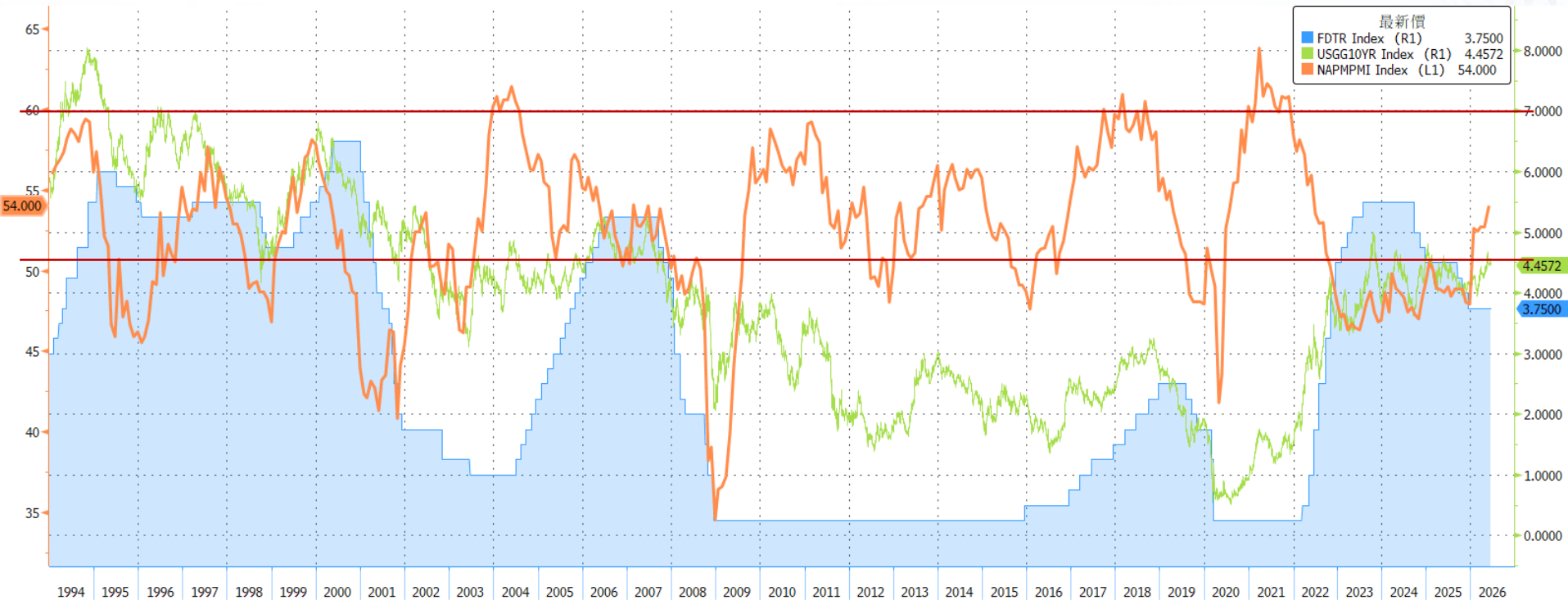
縮表 (QT)

核心目標：收回流動性、防範泡沫

- 抽走 QE 時代遺留在金融體系的過剩資金
- 逼迫資金從「金融帳戶空轉」流向「實體製造投資」
- 恢復市場正常的定價功能，追求「健全貨幣 (Sound Money)」

降息管「價」(資金成本)，縮表管「量」(資金水位)
兩者並行，是為了在不引發衰退的前提下，完成資產負債表的正常化

無論降不降息，當前的利率點位都不會阻礙AI的強勁發展趨勢

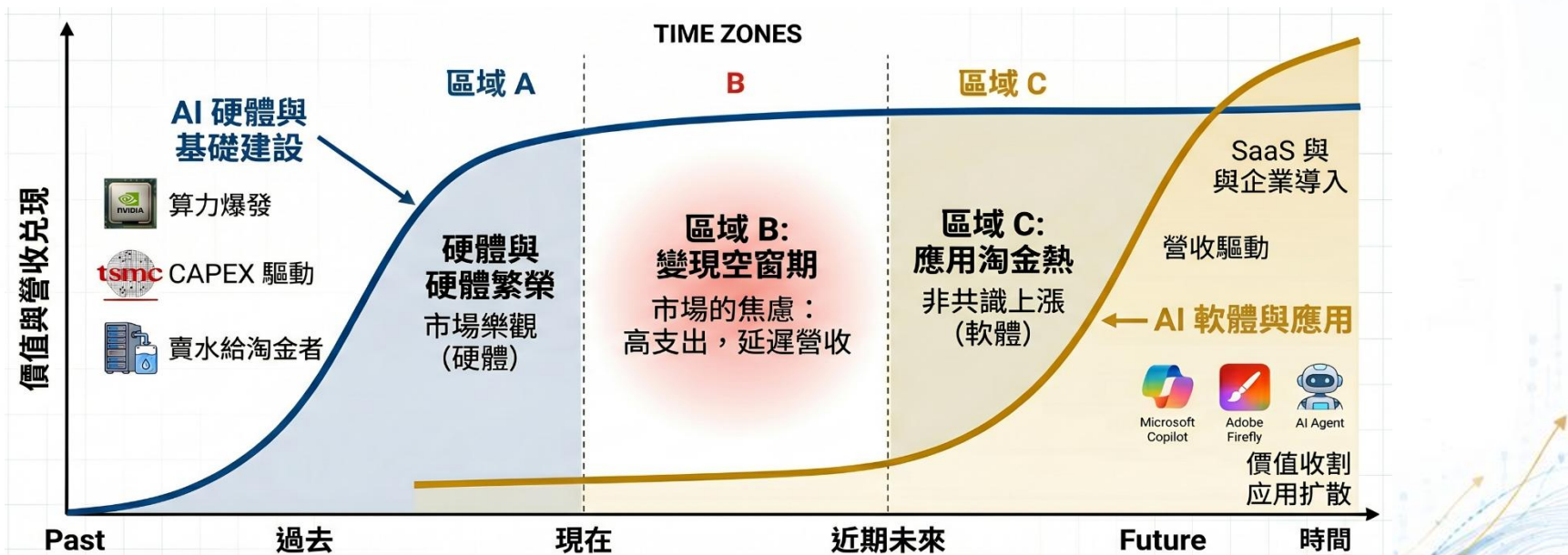


03 AI商業變現與市場機會

上半年AI 硬體紅利持續發酵，下半年應用端精彩可期

- 隨著下半年多元場景加速成型，AI 應用將正式開啟變現週期，展現更具張力的增長曲線。

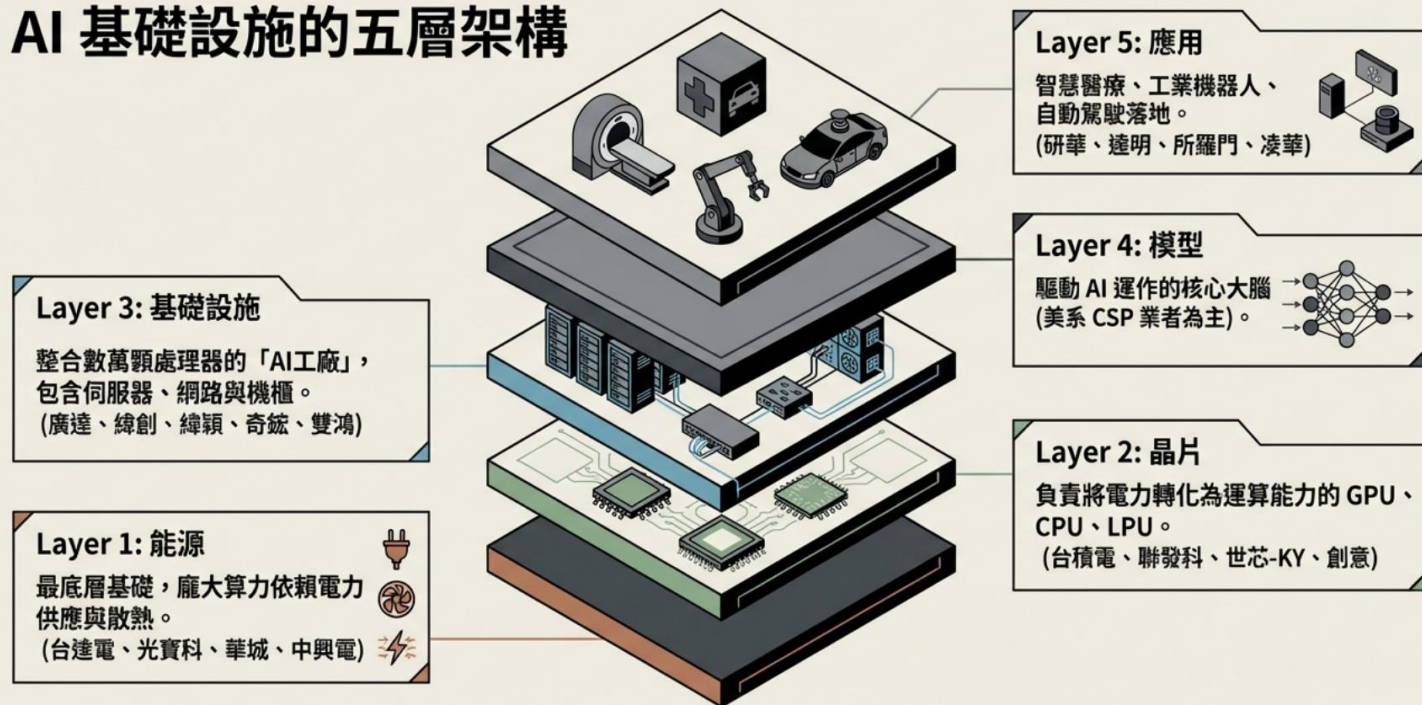
AI價值:從基礎建設到應用階段的時序移轉



AI 靈魂(軟體)在矽谷，但 AI 骨骼與血肉(硬體)全在台灣

- 2026 年各國不僅買晶片，更在建立自主算力，而台灣是唯一的「交機中心」。

AI 基礎設施的五層架構



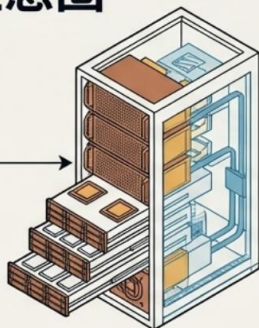
從「通用AI」往「物理AI」持續推進，AI Server設計更多元

- Rubin朝Multi Rack設計強調各司其職，從GPU走向CPU，記憶體、傳輸重要性提升。

Vera Rubin 系統架構： 7 款晶片與 5 款機架生態圈

運算核心 (Compute Orbit)

Rubin GPU (NVFP4 加速)
Vera CPU (單執行緒強化)
Groq 3 LPU (推論專用)



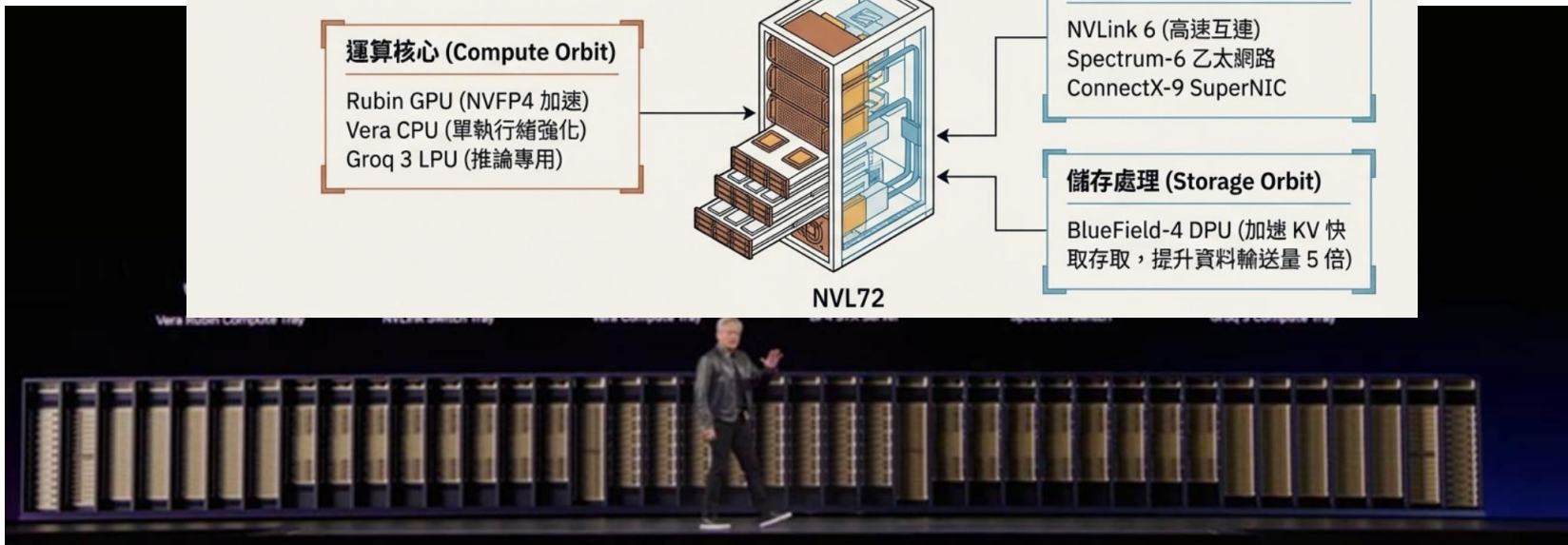
NVL72

網路傳輸 (Network Orbit)

NVLink 6 (高速互連)
Spectrum-6 乙太網路
ConnectX-9 SuperNIC

儲存處理 (Storage Orbit)

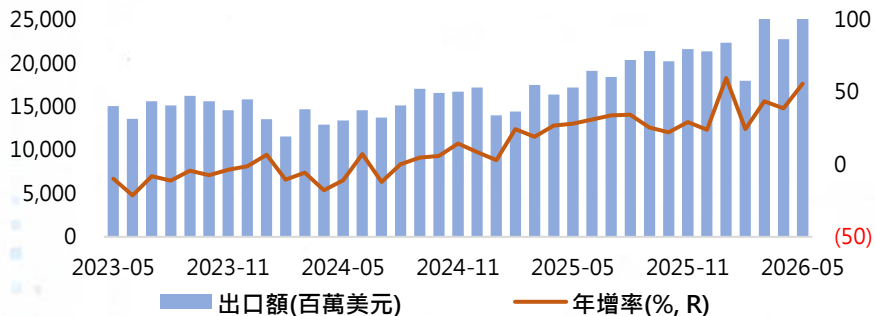
BlueField-4 DPU (加速 KV 快
取存取，提升資料輸送量 5 倍)



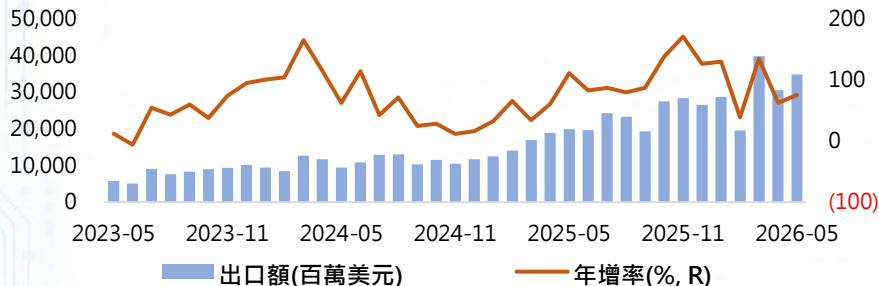
AI 基礎設施需求外溢，持續挹注台灣經濟增長強勁動能

- AI 需求從算力外溢至電力與冷卻，台灣憑藉全產業鏈優勢，承接全球紅利。

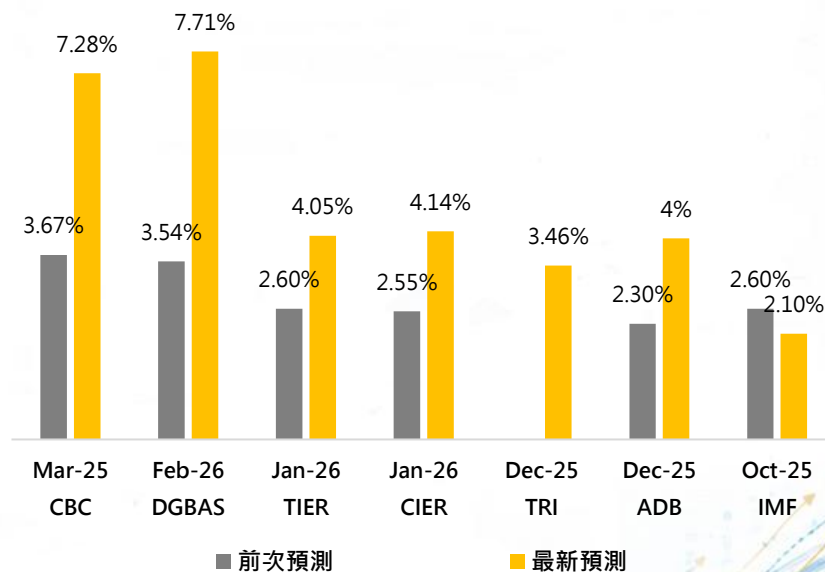
台灣-電子零組件出口



台灣-資通與視聽產品出口



台灣2026年GDP增速預估(4月更新)



TSMC與CSP財報季再度上修CAPEX

- AI推理讓需求來的措手不及
- 從半導體到零組件，擴廠時間至少>1年
- 2026年缺貨漲價將持續發酵
- TSMC+台灣強大的先進封測及PCB供應鏈
→IP業者搶蝕ASIC商機：MTK、世芯、創意

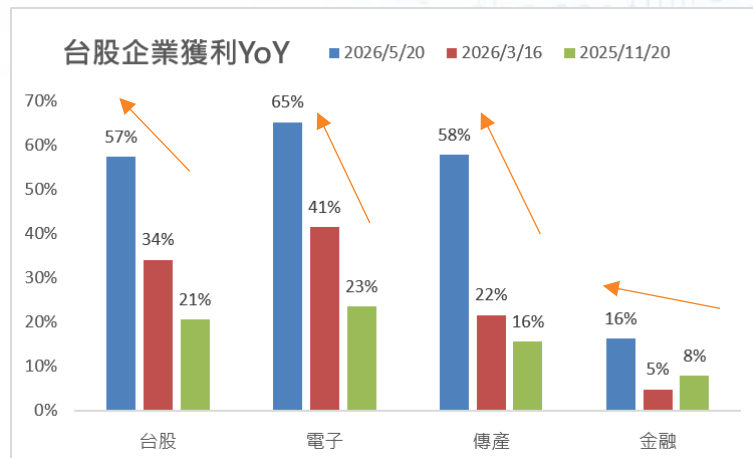
億美元	2025年	2026年	2026年YoY	2026年(2月)
Google	915	1,900	108%	1,850
Amazon	1,285	2,000	56%	2,000
Meta	700	1,350	93%	1,350
微軟	1,100	1,900	73%	1,200
四大CSP資本支出	4,000	7,150	79%	6,400

- 資本支出大上修的台灣供應鏈：半導體供應鏈、先進封測、PCB
- 供不應求台灣漲價概念：記憶體、銅箔、CCL、載板、E Glass布、MLCC

台積電法說會重點		
	2026/1/15	2026/4/16
1Q26 損益表	營收346-358億美元 營收QoQ+4.5%~+8.1% GM 63%-65%	1Q26營收1.134兆元台幣 營收+8.4% QoQ 外資報告抓GM 64%~66.8%
財務預測	2026年營收增加30% YoY 2024年-2029年美元營收CAGR從20%上修至25%	2Q26 營收390-402億美元 +9%~+12.4% QoQ GM 65.5%~67.5%
AI趨勢	2024年-2029年AI營收CAGR從45%修至55%~59%	不含CPU Server，CAGR 55%~59%
資本支出	2026年520-560億元，成長29%~37% YoY 70%-80%用於先進製程(2nm/A16) 10%-20%用於先進封裝(CoWoS等) 預計未來三年資本支出較過去三年顯著提升	2nm良率佳、3nm繼續擴產 (供給吃緊) 先進製程、先進封裝訂單滿，有外包 AI需求有利定價策略
製程	2nm於4Q25量產 N2P及A16預計2H26為AI及高效能晶片提供更強動力	資本支出概念股受惠 玻璃基板、3D SoIC

2026年台股獲利上修至成長57% YoY

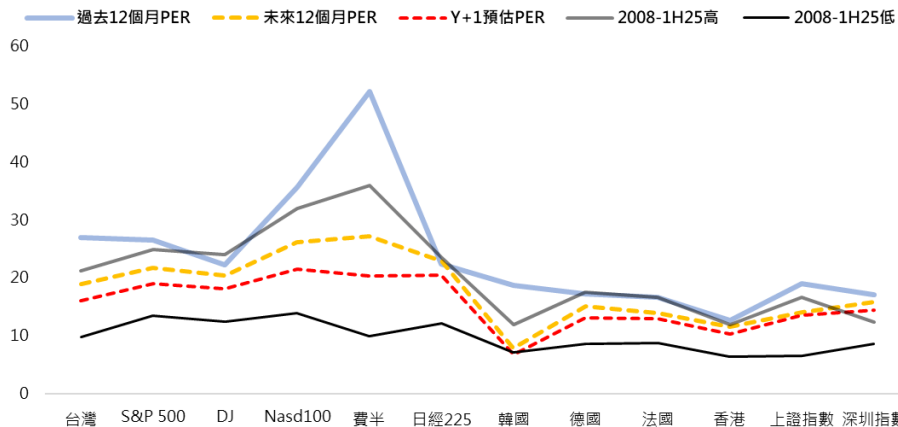
- 2026台股整體企業獲利推算近7兆元。
- 統一投顧核心持股獲利預測，上修至+57% YoY。
- 電子產業顯著上修，圍繞在AI相關。
- 傳產在戰爭影響下，塑化族群及船運也呈現上修。



獲利(百萬元)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25F	1Q26F	2Q26F	3Q26F	4Q26F	2024	2025	2026
台股	895,480	753,726	1,083,260	1,114,197	1,339,542	1,465,224	1,636,555	1,606,893	3,329,179	3,846,663	6,048,214
電子	632,018	627,316	790,151	851,720	1,015,081	1,132,688	1,294,791	1,347,670	2,152,131	2,901,205	4,790,230
傳產	112,780	38,691	120,171	111,842	142,988	152,262	165,889	143,489	622,869	383,483	604,628
金融	150,682	87,719	172,938	150,636	181,472	180,275	175,875	115,734	554,180	561,975	653,356
YoY	1Q25	2Q25	3Q25F	4Q25F	1Q26F	2Q26F	3Q26F	4Q26F	獲利YoY	2025	2026
台股	28.3%	-8.3%	14.5%	29.1%	49.6%	94.4%	51.1%	44.2%	台股	15.5%	57.2%
電子	48.7%	25.1%	33.0%	34.9%	60.6%	80.6%	63.9%	58.2%	電子	34.8%	65.1%
傳產	-8.7%	-76.4%	-38.3%	-20.3%	26.8%	293.5%	38.0%	28.3%	傳產	-38.4%	57.7%
金融	1.0%	-44.0%	9.9%	65.2%	20.4%	105.5%	1.7%	-23.2%	金融	1.4%	16.3%

獲利大增長，指數大躍進

- 若TSMC 3000元(3000-2330)*8=5360
- 42000+5360=47360
- 未來12個月PER 18.96，Y+1 PER 16.14→2027年評價仍不高。



費半、韓國及台股，未來獲利成長性最大，顯示AI硬體紅利先行

台股指數敏感度分析

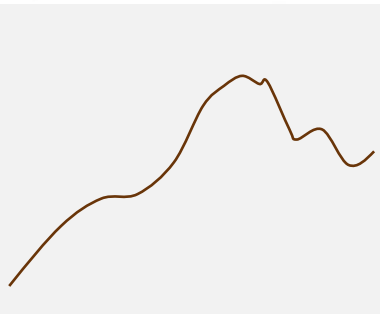
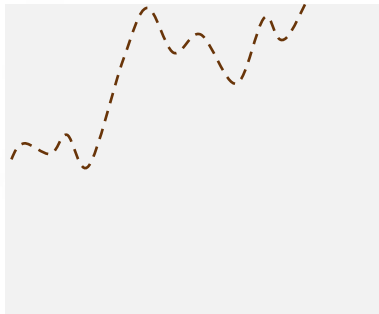

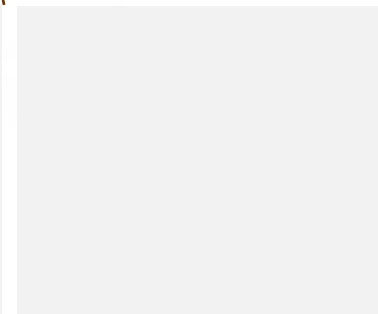
PER 獲利	15.5X (長期平均)	19X (年平均)	22X (年最高)	25X 戴維斯 雙擊
4.5兆 (2025年 高點)	21,075	25,834	28,554	
6.3兆 (2026年 成長40%)	29,505	36,168	39,976	45,427
6.75兆 (2026年 成長50%)	31,613	38,751	42,831	48,672
7兆 (2026年 成長55%)	32,666	40,042	44,259	50,294

2026年台股走勢及季度大事-年中震、年底迎新高

策略

指數走勢

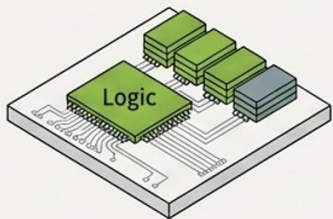
題材事件重點

2026年			
1Q	2Q	3Q	4Q
積極布局	逢回承接，擇優布局	逢回承接，擇優布局	順勢加碼，偏多操作
			
<ul style="list-style-type: none"> • 宣布FED新任主席人選 • 1/30美國政府再次關門?? • CES、MWC等電子大展 • Nvidia GTC/光通展 • 大而美法案眾多項目上路-半導體投資稅收抵免提高至35% • 董事會宣告配息 	<ul style="list-style-type: none"> • 川習會 • FED新任主席上任 / 降息 • 美伊戰爭及高油價置後影響 • AWS Trn3出貨 • Computex • Google I/O開發者大會 • 6/11-7/19 FIFA世足賽 • 股東會旺季 • 大股東賣股繳稅 	<ul style="list-style-type: none"> • 7/4為美國建國250年 • 全球央行年會-8月 • Nvidia Rubin出貨 • Google TPU v8出貨 • Apple iPhone18-摺疊機/OLED • SEMICON國際半導體展 • 除權息旺季 	<ul style="list-style-type: none"> • 美國期中選舉-11月 • 台灣九合一大選-11/28 • AI代理應用商機落實 • 2027年作夢行情 • 感恩節~聖誕節消費旺季 • 中國十一假期 • 雙十一、雙十二

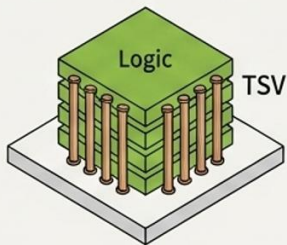
機會：台積電三層蛋糕，先進製程、3D IC、COUPE

先進封裝 (Advanced Packaging)

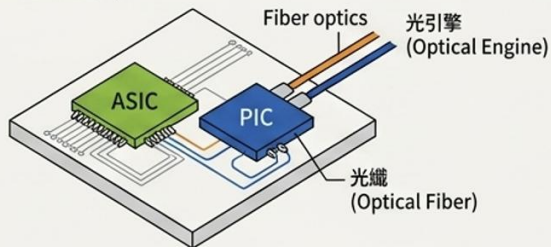
目前的 CoWoS



未來的 3D IC

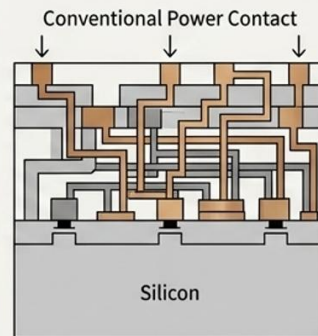


CPO (共同封裝光學)

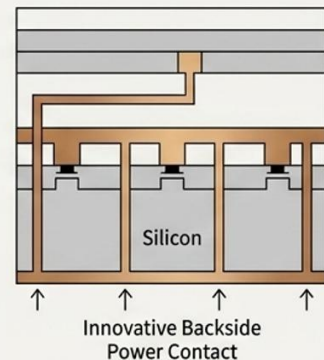


供電網路革命 (Power Delivery Network)

傳統供電
(Conventional Power)

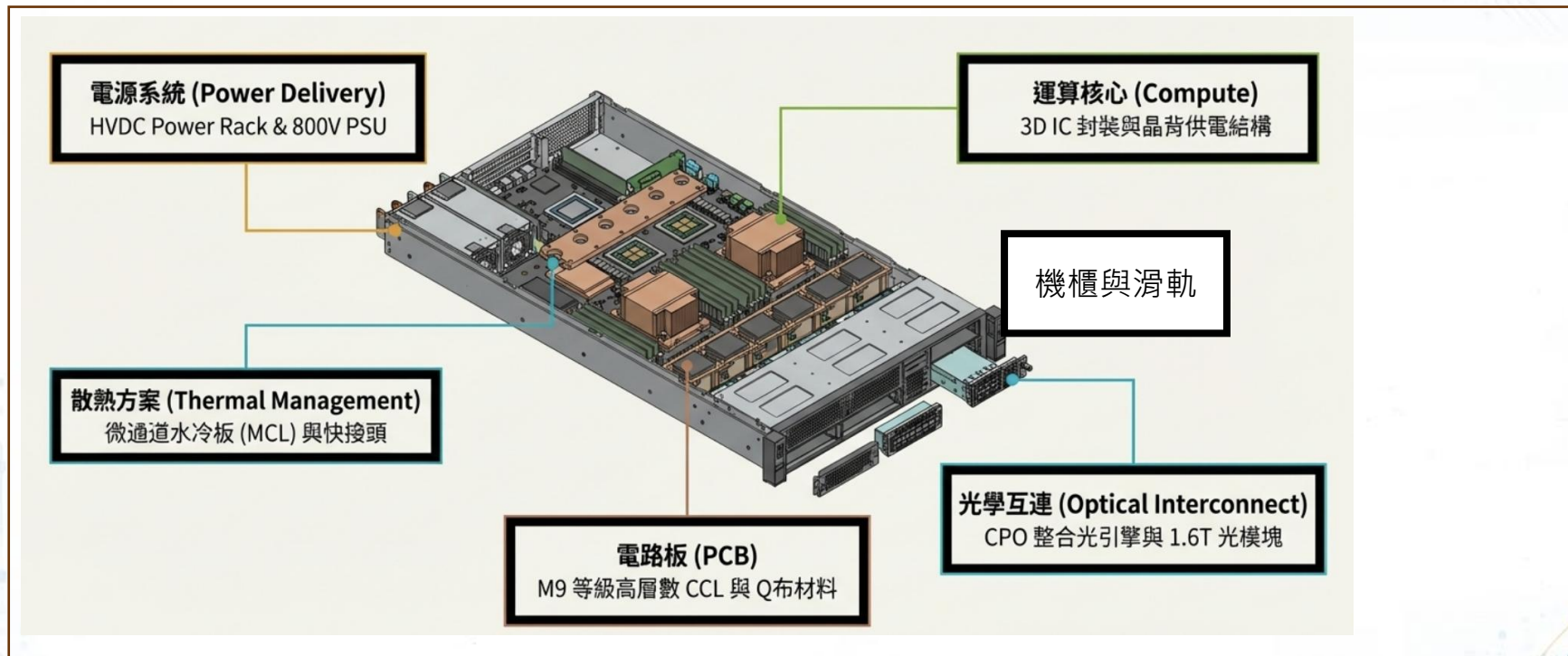


晶背供電
(Backside Power Delivery)



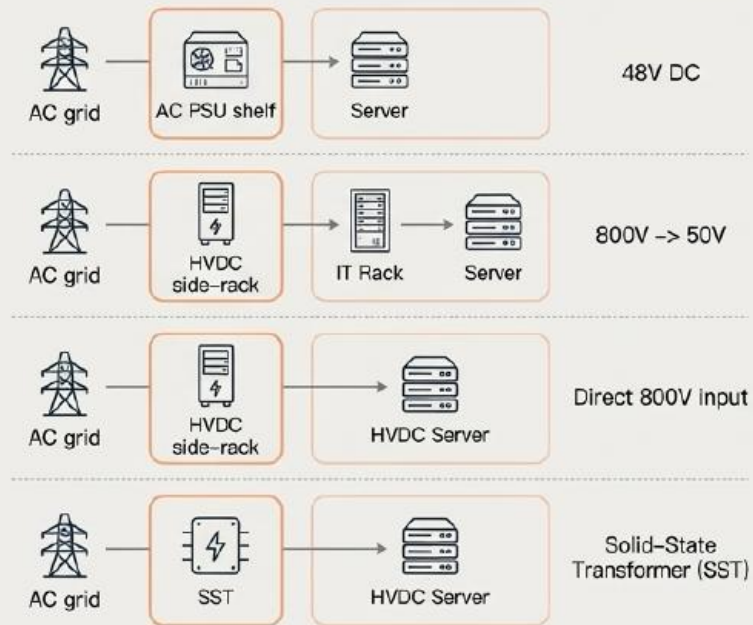
台積電將於 2026 年導入超級電軌，供電網路轉移至背面，大幅改善供電效率與訊號完整性。

機會：AI規格升級，零組件升級，數量更多



機會：電源架構迎來世代革命，全面邁向高壓直流(HVDC)

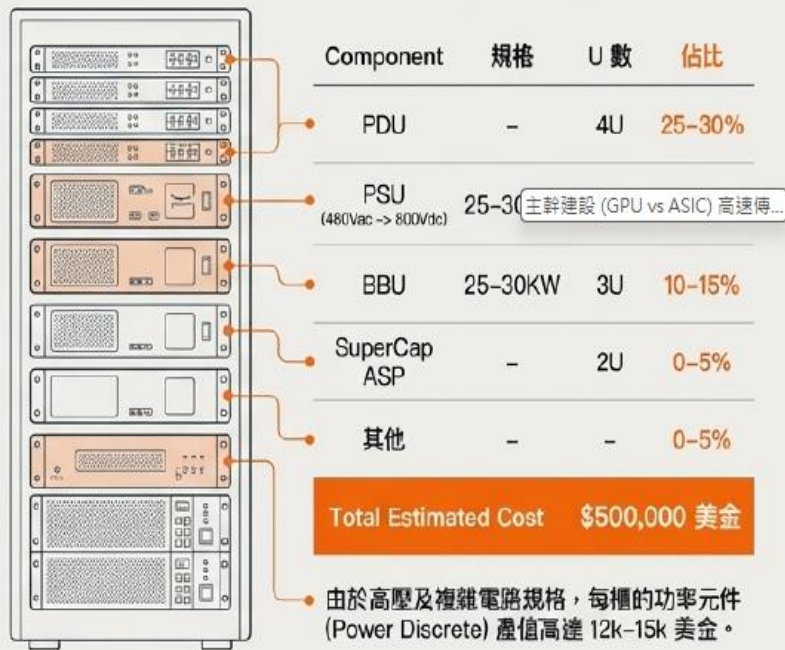
The HVDC Evolution Roadmap



2026年 400V 推出，2027年 800V 推出，ASIC 晶片將先行採用。

Delta、Infineon、統一投顧整理

HVDC Power Rack Content Value



機會：熱能管理更極致，液冷為散熱技術之必然演進

項目	GB200 機櫃	VR200 (含 CPX) 機櫃
水冷板 (Cold Plates)	126 片	261 片
快接頭 (Quick Disconnects)	72 組	252 組
整櫃產值預估成長	基準	成長高達 54%

L

工程瓶頸: Nvidia Rubin Ultra (垂直插入設計，144顆 GPU) 的 **TDP 高達 3600W**，徹底超越傳統氣冷極限。

解決方案: Vera Rubin 平台採用 **100% 液冷設計**，下一代**微通道水冷 (MCL) 技術**與 **45度溫水冷卻**成為推進散熱效率、降低資料中心 **PUE** 的唯一解方。

	GB200	GB300	VR200(含CPX)	LPX
水冷板	126	135	261	256
快接頭QD	72	108	252	384

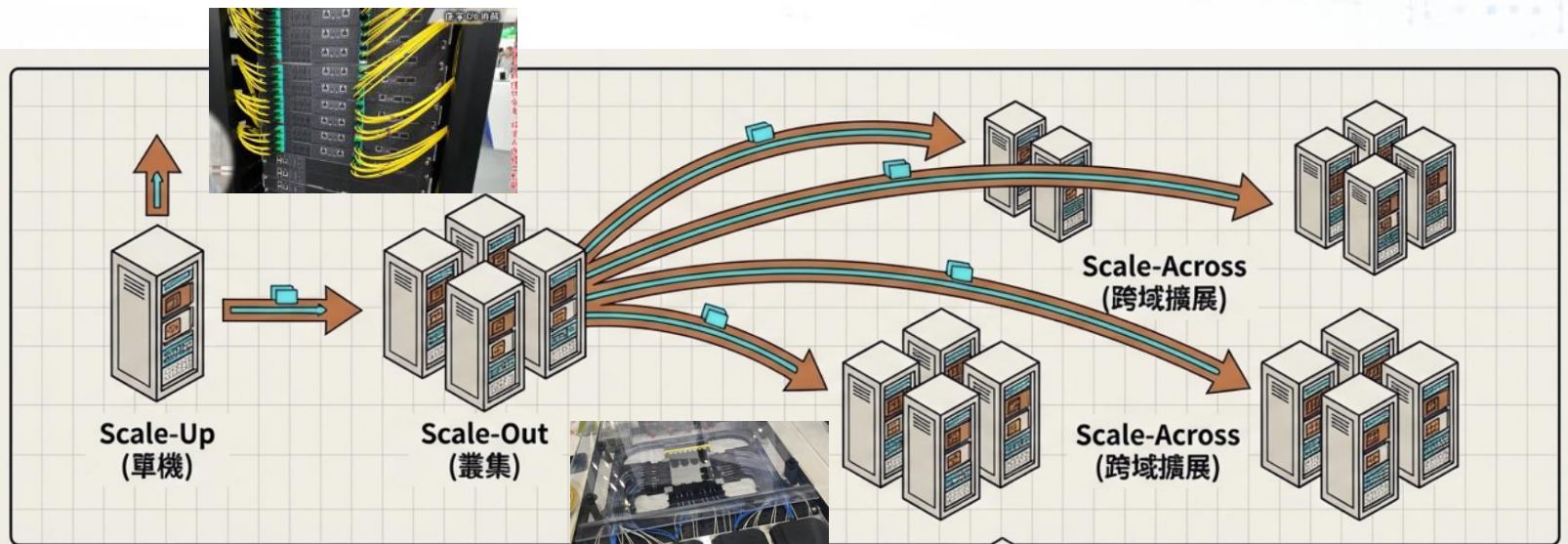
機會：PCB(含載板)是AI基礎建設瓶頸之所在

	A100	H100/GB200	Rubin	Rubin Ultra
CCL 等級	M7	M8	M9 (價格倍增) 價格倍增	
銅箔	HVLP2		HVLP5 (極低表面粗糙度降低訊號損耗)	
玻璃纖維布	Low DK	Low DK 2	Q-glass (Q布) Q布	



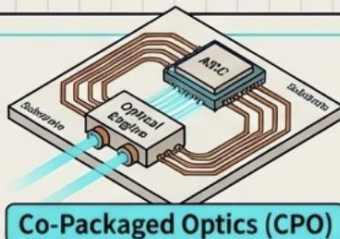
供應鏈危機：高端 Q布 成為繼 HBM 後下一個大缺貨的關鍵零組件。Nvidia 黃仁勳親訪日本日東紡 (NittoBo) 確保產能，新增產能需至 2026 年底才能量產。

機會：克服傳輸瓶頸，光銅並進是最佳解



光學革命 (Optical Revolution)

為防止 GPU 閒置 (GPU Starvation)，**1.6T 光模塊**成為連接 **Rubin 叢集**的標準，目標讓數萬個 GPU 跨機櫃表現如單一系統。



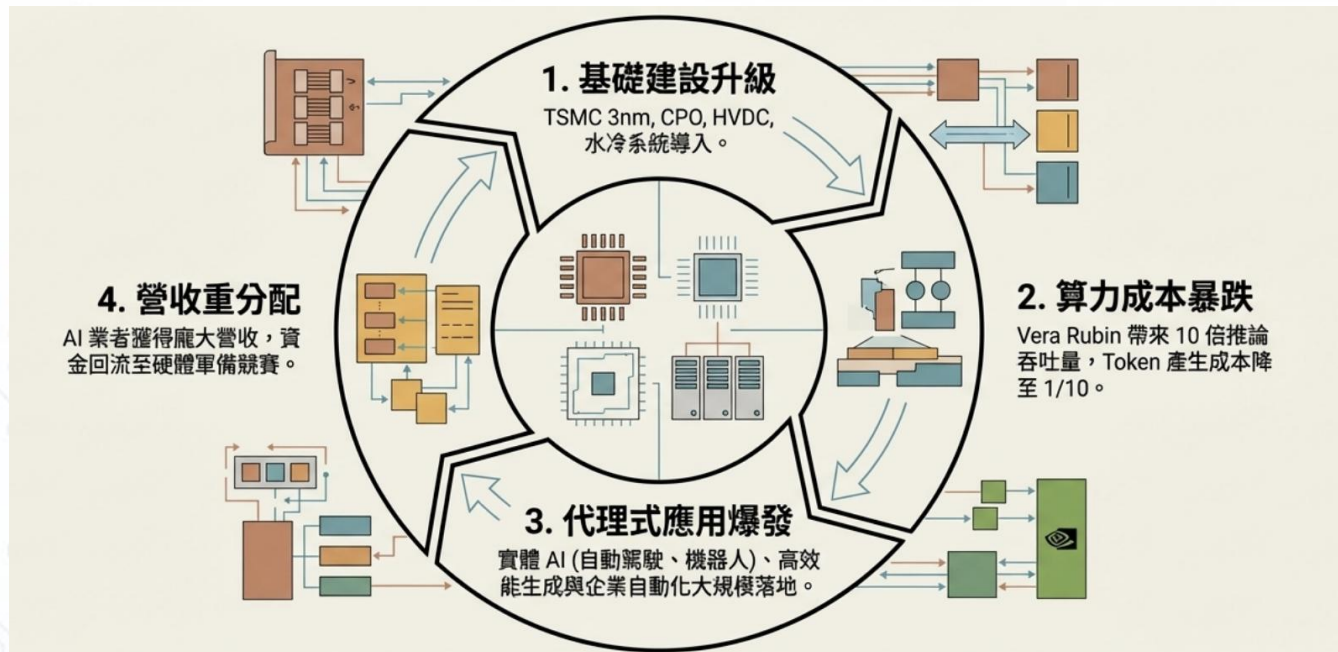
Co-Packaged Optics (CPO)

共同封裝光學 (CPO)：

Spectrum-X 機架導入 CPO 技術，省去可插拔收發器。光學能效比提升 5 倍，系統韌性提升 10 倍。

從算力基建邁向物理 AI，2026 迎來硬體變現元年

2026 年是Edge AI 規模化元年，硬體商將開始從軟體訂閱中獲得分潤或週期性的升級紅利



台積電
無塵室設備/SOIC設備
NAND記憶體
PCB(銅箔、CCL)/載板
光傳輸
散熱
Power Supply
滑軌及傳輸線

The background features a light blue and white color scheme with decorative elements. In the top-left corner, there are overlapping geometric shapes in shades of blue and orange. The right side of the slide is adorned with a faint, light blue circuit board pattern. At the bottom right, a stylized line graph with three upward-trending lines (one solid orange, one dashed blue, and one solid blue) is set against a background of wavy blue lines.

簡報結束，請多指教

免責聲明

本文件所載資訊係統一綜合證券股份有限公司（以下稱本公司）應投資人要求而提供參考之用，並非推介或建議買賣任何國內或國外有價證券。閣下不應對本文件的資料和意見加以依賴，亦不可用以取代閣下的任何決定或尋求獨立專業意見（如不論是在財務、法律、會計或稅務或其他意見）的需要。

本文件並非（且不應解釋為）在任何司法管轄區內，任何非依法從事證券經紀或交易之人士或公司，為於該管轄區內從事證券經紀或交易的要約或游說，亦不構成任何合約或締約的基礎或可就任何合約或締約而加以依賴。此外，本文件及其內容不可被詮釋為任何類別或形式的廣告、要約或聲明。本公司保留權利（但並無責任）隨時在不發出通知的情況下更改本文件的資料，而且毋須對有關變動所致的任何後果負責。

本公司當力求資料之正確性，所附資料內容係根據本公司認可之資料來源，並基於特定日期所做之判斷，但不保證其完整性、正確性或即時性和對未來投資成果並不做任何擔保，如資料有錯漏，本公司或受僱人，並不負任何法律責任。報告中所有的意見及預估，如有變更與撤回恕不另行通知。投資人不應對與產品表現相關的任何理論歷史資料過份依賴，請注意國內或國外有價證券過去之表現並不一定是其將來表現的指引，而投資人的投資價值既可能下跌或上升，因此投資人未必一定可取回原來投資的金額。

本公司並無就任何產品或交易的預期或預計成效、盈利能力、回報、表現、結果、影響、後果或利益（不論是在法律、監管、稅務、財務會計或其他方面）作出任何擔保、保證或聲明。因此，本公司概不會就使用或依據本文件或所提供的資料的任何部份而直接或間接引致的任何損失承擔任何責任。

在未獲得本公司的事先書面同意前，本文件不得以任何形式或方式轉載、轉寄、複製或披露，亦不可在任何文件中引用或提述。本文件的資料僅供特定收件人傳閱，並非向本文件的收件人提供的建議或投資意見，因為本文件並無考慮任何個別收件人的特定投資目標、財務狀況、特別需要或特別要求。本公司忠告投資人在作出任何購買或訂立任何產品或交易的締約前，務必詳細閱讀產品說明書及所有相關附錄文件，了解商品風險及所涉風險，並請就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求專業獨立第三人的意見。

© 2020 統一綜合股份有限公司版權所有。統一綜合證券客戶服務專線：(02)8172-4668。